

2003年12月4日

ムーチップを用いたソリューション事業の強化について

日立製作所（執行役社長：庄山 悦彦）は、世界最小クラスの非接触 IC チップである「ムーチップ」を用いたソリューションビジネスの拡大を目的に、2004年1月1日付で、ムーソリューションズベンチャーカンパニー（カンパニー長&CEO：井村 亮）を再編し、情報・通信グループ内にムーソリューション事業部（仮称）を新設、ムーチップを用いたソリューションビジネスの国内外向けの営業、システムエンジニアを増員するなど体制の強化を図ります。

当社が開発した「ムーチップ」は、0.4mm角の世界最小クラスの IC チップです。製造工程でデータを ROM（読取専用メモリ）に書き込むことから書き換えができず、高い真正性が保証されます。

当社では、この「ムーチップ」を用いたソリューション事業の早期に立ち上げを目的に、2001年7月に社内ベンチャーカンパニーである「ムーソリューションズベンチャーカンパニー」を設立し、次世代非接触 IC チップ市場を開拓してきました。

ムーチップは、これまでに、これらの特長を活かして、鋼材流通の現場における現品管理システムや2005年3月25日から開催される2005年日本国際博覧会（愛・地球博）の入場券システムなどに採用されています。

当社では、ムーチップをはじめとする RFID タグを用いたソリューションビジネスを「新時代のライフラインを支えるソリューション」事業として注力しています。今回の組織再編、体制の強化は、今後、RFID タグを用いたビジネスの拡大が予想される金融、公共、産業、流通といった分野へのさらなる強化と業界を横断した分野への対応、海外での事業拡大に対応するために行うものです。具体的には、国内外向けの営業、システムエンジニアを増員するとともに、情報通信ビジネスとの連携をさらに強化するため、社内ベンチャーカンパニーであるムーソリューションズベンチャーカンパニーを情報・通信グループの事業部とします。

当社では、今後サプライチェーンマネジメントや品質管理、偽造防止、トレーサビリティなど多くの分野で、世界中のお客様やパートナーとともに、ムーチップを用いた新たなビジネスモデルを構築して市場を創出し、2005年度には、約150億円の売上高を見込み、2006年度以降の更なる成長を目指します。

以上

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
